보 도 설 명 자 료
('23. 4. 3.)

수신 : 산업통상자원부 등록기자

제목 : 정부는 반도체 칩 제작지원 확대를 위해 파운드리 기업들과 협의 중에 있음

(4.3일 서울경제「대학원생 '칩 제작' 뚝 반도체 미래가 헛돈다」보도에 대한 설명)

---

1. 기사내용

□ IDEC*의 석·박사 대학원 대상 반도체 칩 제작지원 감소에 따라 반도체 제작 지원 학교의 반도체 설계 실습 건수 감소

* IDEC(IC Design Education Center) : KAIST 산하의 반도체설계 교육센터로 산업부의 예산지원을 통해 반도체설계 인력양성을 위한 교육 및 반도체 칩 제작 지원 중

2. 동 보도내용에 대한 입장

□ 정부는 반도체설계 석·박사 인력양성을 위해 반도체 설계실습을 위한 MPW*를 삼성전자·DB하이텍·매그나칩 등으로부터 공급받아 지원 중

* MPW(Multi-Project Wafer) : 연구개발용 칩 시제품 여러개를 웨이퍼 한 장에 제작하여 파운드리 공정을 통해 설계된 칩의 성능·검사 등을 진행할 수 있는 서비스

○ 다만, 최근 코로나19로 파운드리 공정의 수요가 급증함에 따라 기업의 MPW 제공 물량이 감소

□ 이에 정부는 MPW 지원 확대를 위해 올해 삼성전자의 MPW 제공 확대 등을 확인하였으며, 그외 파운드리 기업의 MPW 지원 확대를 위해 적극 노력하겠음

※ 문의 : 반도체과 이규봉 과장(044-203-4270), 조예은 주무관(4254)